財團法人工業技術研究院　函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：李怡秋
電話：03-5917759
傳真：03-5820466
E-mail：Lislee@itri.org.tw

1110022175001

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 111. 11. 04 文
檔號: 011597

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 111 年 11 月 03 日
發文字號：工研轉字第 1110022175 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：本院擬舉辦「111 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案」之公開招標活動，請轉知貴會會員等相關廠商把握機會參與本次推廣活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦 111 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案(專利 27 案 51 件)之公開招標活動（讓與標的詳如附件）。

二、「讓與標的」共分為四個類別：（一）醫藥(8 案 15 件)、（二）體外診斷(2 案 3 件)、（三）再生醫學(4 案 9 件)、（四）醫療電子(13 案 24 件)。

三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：

（一）本案截標日為民國（下同）111 年 11 月 21 日，初審日為 111 年 11 月 23 日及複審日為 111 年 12 月 14 日。

（二）詳細投標訊息及讓與標的資料，請參考工研院研發成果公告網站（https://itriwww.itri.org.tw/ListStyl

e.aspx?DisplayStyle=01_content&SiteID=1&MmmID=1036461244216621372&MGID=1164121664446564631）。

（三）公開說明會資訊：

1.舉辦時間：111 年 11 月 9 日 14 時。

2.舉辦地點：採線上方式辦理。

3.報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 11 月 8 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（請於電子郵件主旨上註明「111 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 11 月 8 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐

電話：（03）591-7759

傳真：（03）582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

111 年度工研院生醫與醫材研究所
醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 27 案 51 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

（一）醫藥 8 案 15 件；

（二）體外診斷 2 案 3 件；

（三）再生醫學 4 案 9 件；

（四）醫療電子 13 案 24 件。

「讓與標的」並無共有專利，「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）111 年 11 月 9 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 111 年 11 月 8 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「111 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 111 年 11 月 8 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 111 年 11 月 21 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

（一）本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1.（密封）價格封。

2.押標金。

3.公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）。

4.近兩年財報資料。

5.公司基本資料暨運用規劃說明表。

6.商業營運計畫書一式 7 份。（若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。）

（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「111 年度工研院生醫與醫材研究所醫藥／體外診斷／再生醫學／醫療電子等專利讓與案投標」，於截標日 111 年 11 月 21 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 李小姐收。

（二）廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額。

（三）商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1.公司背景／關係企業／合作夥伴簡介（20%）

2.公司財務狀況（20%）

3.公司營運／研發能力（20%）

4.「讓與標的」運用規劃（30%）

5.國內產業效益（10%）

（如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等）

（四）投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。（「讓與標的」以同一發明為一案。）

（五）本讓與案不得共同投標或重複投標。

（六）投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

（七）投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

（一）押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）。

（二）押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明

禁止背書轉讓。

（三）得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

（一）投標時間截止後之投標。

（二）開標前業已公告停止本讓與案交易程序。

（三）投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。

（四）投標單附加任何成交條件者。

（五）投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。

（六）投標文件有所缺漏者。

（七）投標時押標金未達總投標金額之 10%者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標時仍未能補足者，其投標為無效。

（八）投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。

（九）投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

（一）分為初審（開標日為 111 年 11 月 23 日）及複審（決標日為 111 年 12 月 14 日），投標廠商於通過初審後，始能進入複審。會另行通知投標廠商，請廠商依通知時間進行複審。

（二）得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

（三）初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、近兩年財報資料、商業營運計畫書、價格封進行書面審查及確認。

（四）投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書進行複審，投標廠商於決標日應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。

（五）投標廠商若有境外實施需求，除於公司基本資料暨運用規劃表中敘明境外實施金額，並於複審時報告說明。

（六）複審時，工研院開標審議委員會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商底價單，將以投標廠商金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商可優先有一次加價機會，若此加價仍無超過底價，之後則由所有投標廠商同時議價，所有投標廠商間的同時比增價格以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上投標廠商總評比分數均超過及格分，投標金額亦均超過底價且相同，得提供投標廠商議價機

會，並以高價者決標。比增價格以三次為限，若比增三次後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)

(七) 決標時將請律師到場監標。

(八) 決標後將個別通知投標廠商決標結果(不公告得標廠商)。

(九) 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

(一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。

(二) 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

(三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本讓與案公告之投標廠商資格。

(四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定)。前述法令變動時，亦同。

(五) 得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。

(六) 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。

(七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人(以下簡稱「後手」)時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。

（八）得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：

1.工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；

2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；

3.工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。

（九）得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

（十）「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

（十一）「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或輾轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與後手之讓與契約，否則即視為將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

（十五）基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

（十六）得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或

裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

（十七）得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 李小姐。

電話：（03）591-7759，傳真：（03）582-0466。

電子信箱：lislee@itri.org.tw。

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

附件：專利清單

分類	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利證號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
醫藥	1	P13940006TW	兩性團聯共聚高分子及包含此共聚高分子之奈米微粒	中華民國	獲證	94147662	I306869	20090301	20251229	v
		P13940006TWC1	兩性團聯共聚高分子及包含此共聚高分子之奈米微粒	中華民國	獲證	95141281	I314461	20090911	20261107	v
		P13940006US	兩性團聯共聚高分子及包含此共聚高分子之奈米微粒	美國	獲證	11/268,544	8124128	20120228	20270511	v
		P13940006USC1	兩性團聯共聚高分子及包含此共聚高分子之奈米微粒	美國	獲證	12/053,327	8940333	20150127	20270511	v
	2	P56000019TW	抗人類表皮生長因子受體抗體及其應用	中華民國	獲證	100149126	I443108	20140701	20311227	
		P56000019US	抗人類表皮生長因子受體抗體及其應用	美國	獲證	13/611,291	8758756	20140624	20320911	
	3	P56000021TW	抗人類輸鐵蛋白受體的單域抗體與其應用	中華民國	獲證	100149460	I450727	20140901	20311228	
		P56000021US	抗人類輸鐵蛋白受體的單域抗體與其應用	美國	獲證	13/610,583	8663598	20140304	20320910	
	4	P56950004GB	奠化合物	英國	獲證	07021259.2	EP1918277	20150610	20271030	
	5	P56980009TW	可通過血腦障壁之胜肽及包含此胜肽之傳輸系統	中華民國	獲證	99146311	I472348	20150211	20301227	
		P56980009US	可通過血腦障壁之胜肽;及包含此胜肽之傳輸系統	美國	獲證	12/979,804	8697841	20140415	20320305	
	6	P56990022CN	可控制釋放的組合物及其制造方法	中國大陸	獲證	201110409553.9	ZL201110409553.9	20150826	20311208	
		P56990022TW	可控制釋放的組合物及其製造方法	中華民國	獲證	100144309	I501781	20151001	20311201	
	7	P56020008TW	經分離之人類肝癌細胞株及化合物篩選方法	中華民國	獲證	102145618	I486451	20150601	20331210	
	8	P56020009TW	經分離之人類肝癌細胞株及化合物篩選方法	中華民國	獲證	102145617	I461535	20141121	20331210	
體外診斷	9	P56990002TW	將福馬林固定石蠟包埋之組織進行脫蠟的方法與其套組	中華民國	獲證	99140497	I425977	20140211	20301123	
		P56990002US	將福馬林固定石蠟包埋之組織進行脫蠟的方法與其套組	美國	獲證	12/979,979	8574868	20131105	20311213	
	10	P64970014TW	葡萄糖檢測方法	中華民國	獲證	97151754	I378238	20121201	20281230	
再生醫學	11	P51020056TW	細胞培養裝置及承載細胞件	中華民國	獲證	102146847	I486442	20150601	20331217	

分類	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利證號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
	12	P56000018TW	人源化之抗人類細胞表面抗原 CD34 之單株抗體及其應用	中華民國	獲證	100149470	I443107	20140701	20311228	v
		P56000018US	人源化之抗人類細胞表面抗原 CD34 之單株抗體及其應用	美國	獲證	13/646,530	8927696	20150106	20321207	v
	13	P56980010TW	骨修復套組	中華民國	獲證	98145620	I413504	20131101	20291228	
		P56980010US	骨修復套組	美國	獲證	12/830,536	8603092	20131210	20310724	
		P56980010USD1	骨修復套組	美國	獲證	14/072,841	8834470	20140916	20300705	
	14	P64960022TWC1	溫度敏感性材料	中華民國	獲證	97141336	I388591	20130311	20281027	
		P64960022US	生物可分解共聚物與溫度敏感性材料	美國	獲證	12/395,495	7884142	20110208	20290226	
		P64960022USC1	溫度敏感性材料	美國	獲證	12/952,724	8309623	20121113	20290226	
醫療電子	15	P51000068TW	分子檢測感測器之微奈米金屬結構及其製作方法	中華民國	獲證	100147992	I480225	20150411	20311221	
	16	P51000090CN	景深拓展相位物體顯微系統	中國大陸	獲證	201210019732.6	ZL201210019732.6	20151125	20320115	
		P51000090TW	相位物體顯微系統	中華民國	獲證	100141603	I467226	20150101	20311114	
		P51000090US	相位物體顯微系統	美國	獲證	13/354,339	9116101	20150825	20331013	
	17	P51000095CN	具有自動對焦功能的診斷設備	中國大陸	獲證	201210411541.4	ZL201210411541.4	20150311	20321023	
		P51000095TW	具有自動對焦功能之診斷設備	中華民國	獲證	100149644	I453523	20140921	20311228	
		P51000095USA1	具有自動對焦功能之診斷設備	美國	獲證	13/727,664	8894206	20141125	20321226	
	18	P51000175CN	測距裝置、測距方法及互動式顯示系統	中國大陸	獲證	201210294992.4	ZL201210294992.4	20150513	20320816	
		P51000175US	測距裝置、測距方法及互動式顯示系統	美國	獲證	13/653,418	9098147	20150804	20330322	
	19	P51010029TW	用於增加景深之方法及使用此方法之超音波成像系統	中華民國	獲證	102109543	I461688	20141121	20330317	v
	20	P51020014TW	電壓保護傳輸裝置及包括該裝置的電壓保護裝置	中華民國	獲證	102127971	I502836	20151001	20330804	

分類	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利證號	專利起期	專利迄期	授權紀錄
	21	P51980151TW	螢光顯微影像系統	中華民國	獲證	99116015	I456254	20141011	20300518	
		P51980151US	螢光顯微影像系統	美國	獲證	12/872,910	8410414	20130402	20310621	
	22	P51990112TW	條碼讀取裝置與條碼讀取方法	中華民國	獲證	100101463	I427540	20140221	20310113	
	23	P56000004TW	力感測裝置及其力感測系統	中華民國	獲證	100121712	I510768	20151201	20310620	
	24	P56000016CN	超聲波成像系統及其圖像處理方法	中國大陸	獲證	201210076015.7	ZL201210076015.7	20150128	20320320	
		P56000016TW	超音波成像系統及其影像處理方法	中華民國	獲證	100148936	I453404	20140921	20311226	
		P56000016US	超音波成像系統及其影像處理方法	美國	獲證	13/558,362	8744128	20140603	20321113	
	25	P56000017CN	信號分析方法、超聲波圖像分析方法以及超聲波成像系統	中國大陸	獲證	201210073203.4	ZL201210073203.4	20150805	20320318	
		P56000017TW	訊號分析方法、超音波影像分析方法以及超音波成像系統	中華民國	獲證	100148921	I482613	20150501	20311226	
		P56000017US	訊號分析方法、超音波影像分析方法以及超音波成像系統	美國	獲證	13/553,793	8837798	20140916	20321025	
	26	P64980006TW	光聲探頭、光聲探測方法與光聲探測系統	中華民國	獲證	98142968	I396881	20130521	20291214	
	27	P64980018TW	分頻濾波裝置及其方法	中華民國	獲證	98146264	I448072	20140801	20291230	
		P64980018US	分頻濾波裝置及其方法	美國	獲證	12/868,200	8606836	20131210	20320727	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。